

# 2025-2031年中国晶圆制造行业市场竞争策略及未来发展潜力报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2025-2031年中国晶圆制造行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202110/978212.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国晶圆制造行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》（以下简称《报告》）正式揭晓，自2018年出版以来，已连续畅销7年，成功成为企业了解和开拓市场，制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发，深入剖析了晶圆制造行业未来的市场动向，精准挖掘了行业的发展潜力，并对晶圆制造行业的未来前景进行研判。

本报告共四章，包含2023年半导体市场，2023年晶圆制造产业简介，晶圆制造行业主要企业分析等内容。

报告中所有数据，均来自官方机构、行业协会等公开资料以及深入调研获取所得，并且数据经过详细核实和多方求证，以期为行业提供精准、可靠和有效价值信息！

晶圆制造是指在晶圆表面上或表面内制造出半导体器件的一系列生产过程。晶圆制造是半导体制造业的核心制程，从广义上讲，晶圆制造包括单晶硅制造环节。

近年来，中国晶圆产能稳步增长。2023年，中国晶圆产能合计达658.72万片/月，同比增长13.8%。其中，12英寸占比达到56.9%，8英寸和6英寸占比分别为24.4%和18.6%。

晶圆制造是根据设计出的电路版图，通过炉管、湿刻、淀积、光刻、干刻、注入、退火等不同工艺流程在半导体晶圆基板上形成元器件和互联线，最终输出能够完成功能及性能实现的晶圆片。晶圆制造产业链上游为晶圆设计、原材料、设备；中游为晶圆制造、晶圆封装、晶圆测试、晶圆切割成硅片；下游为半导体、消费电子、智能电网、太阳能电池、二极管等应用领域。

中国晶圆制造行业厂商主要分布在中国的东部沿海地区，特别是那些拥有完善产业链、丰富人才资源以及良好政策支持的地地区，包括北京市、山东省、江苏省、上海市、安徽省、浙江省、福建省、广东省等省市。

作为一个见证了中国晶圆制造十余年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与晶圆制造行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。

报告目录：

第一章 晶圆制造简介

第一节 晶圆制造流程

第二节 晶圆制造成本分析

## 第二章 2023年半导体市场

### 第一节 2023年半导体产业分析

#### 第二节 2023年半导体市场上下游状况分析

#### 第三节 2023年全球晶圆制造产业现状

#### 第四节 2023年全球半导体制造产业

##### 一、全球半导体产业概况

##### 二、全球晶圆制造行业概况

#### 第五节 2023年中国半导体产业与市场

##### 一、中国半导体市场

##### 二、中国半导体产业

##### 三、中国IC设计产业

##### 四、中国半导体产业发展趋势

## 第三章 2023年晶圆制造产业简介

### 第一节 晶圆制造工艺简介

#### 第二节 全球晶圆产业及主要厂商简介

#### 第三节 中国半导体产业政策环境

#### 第四节 中国晶圆制造业现状及预测

## 第四章 晶圆制造行业主要企业分析

### 一、中芯国际集成电路制造有限公司

#### （一）企业偿债能力分析

#### （二）企业运营能力分析

#### （三）企业盈利能力分析

### 二、华虹半导体有限公司

#### （一）企业偿债能力分析

#### （二）企业运营能力分析

#### （三）企业盈利能力分析

### 三、合肥晶合集成电路股份有限公司

#### （一）企业偿债能力分析

#### （二）企业运营能力分析

#### （三）企业盈利能力分析

### 四、华润微电子有限公司

#### （一）企业偿债能力分析

- (二) 企业运营能力分析
- (三) 企业盈利能力分析
- 五、上海先进半导体制造有限公司
  - (一) 企业偿债能力分析
  - (二) 企业运营能力分析
  - (三) 企业盈利能力分析
- 六、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司
  - (一) 企业偿债能力分析
  - (二) 企业运营能力分析
  - (三) 企业盈利能力分析
- 七、上海新进半导体制造有限公司
  - (一) 企业偿债能力分析
  - (二) 企业运营能力分析
  - (三) 企业盈利能力分析
- 八、深圳方正微电子有限公司
  - (一) 企业偿债能力分析
  - (二) 企业运营能力分析
  - (三) 企业盈利能力分析
- 十、深圳芯导科技有限公司
  - (一) 企业偿债能力分析
  - (二) 企业运营能力分析
  - (三) 企业盈利能力分析

图表目录：

- 图表1 晶圆制造工艺流程
- 图表2 晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析
- 图表3 2023年度全球营收前13的晶圆制造企业
- 图表4 2025-2031年大陆IC内需市场规模变化与预测
- 图表5 主要代工企业产能分布及收益情况
- 图表6 集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用
- 图表7 全球半导体市场规模超过3000亿美元
- 图表8 半导体产品种类繁多
- 图表9 全球半导体分产品市场占比
- 图表10 中国大陆半导体市场规模近4000亿元
- 图表11 全球半导体产业区域结构发生巨大变化

图表12 北美半导体设备制造商bb 值

图表13 半导体产业链

图表14 近期或者未来有望在A股上市的半导体厂商

图表15 半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低

图表16 封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒

图表17 集成电路封测行业一直占据行业主导地位

图表18 国内十大半导体封装测试企业

图表19 2023年全球晶圆制造排名

图表20 2023年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势

图表21 全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较

图表22 前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势

图表23 全球半导体厂商资本支出集中程度分析

图表24 半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析

图表25 全球半导体设备产业版图的变化

图表26 国内政策对集成电路产业大力支持

图表27 国内半导体进口金额超2000亿美元

图表28 国内集成电路未来三阶段发展目标

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202110/978212.html>